

# 东莞新懿技术BGA底部填充胶，增加强度，耐冲击

产品名称	东莞新懿技术BGA底部填充胶，增加强度，耐冲击
公司名称	东莞市新懿电子材料技术有限公司
价格	12000.00/公斤
规格参数	品牌:新懿技术 型号:3108
公司地址	广东省东莞市大朗镇创意产业园B栋501
联系电话	0769-38862382 18825805993

## 产品详情

### 新懿sct3108底部填充胶

一、应用范围：它能很好的固定csp(fbga)或bga在pcb上，增加pcb与csp(fbga)或bga的贴合强度，能有效降低由于芯片与基板的热膨胀系数不匹配或外力造成的冲击，提高产品的可靠性

外观	无色透明液体
比重 ( 250c , g/ cm3 )	1.15
粘度 ( cone&plate, shear rate 36s-1,25 ) ,cps	2000
闪点 ( )	>100
使用时间 @25 , hours	48

### 二、贮存条件

2-8 温度下，阴凉干燥处，可存放6个月。

### 三、固化条件

#### 推荐的固化条件

5分钟@150

8分钟@120

20分钟@100

备注: 所有的快速固化体系,固化所需的时间取决于升温速率。热板和散热片是快速固化的最佳选择。升温速率取决于所需加热的材料的重量以及和热源的接触方式。推荐的固化条件仅为一般的参考。其它的

固化条件也许能得到更安全的结果。

密度 ( 25 , g/ cm3 )	1.18
收缩率 %	2.5
热膨胀系数um/m/	< tg 63 > tg 210
astm e831-86	
导热系数astm c177 , -1	0.2
吸水率 ( 24hrs in water@25 ) , %	0.16
玻璃化转化温度 tg ( )	31
断裂伸长率 %	3.6
断裂拉伸强度 n/mm2 (psi)	56 ( 8 , 120 )
拉伸模量 n/mm2 (psi)	2 , 200 ( 319 , 100 )
介电常数	3.6 ( 100khz )

密度 ( 25 , g/ cm3 )

介电正切		0.016(100khz)
体积电阻率astm d257 , .cm		4.4* 10 <sup>16</sup>
表面电阻率astm d257,		1.1* 10 <sup>16</sup>
表面绝缘电阻 ,	初始	52*10 <sup>12</sup>
	老化后 ( 85 ,85%rh,96hrs,5 dcv )	8.1*10 <sup>12</sup>
剪切强度 ( 60minutes@100 )	钢 ( 喷砂处理 ) , n/mm2 (psi)	8 ( 1,160 )
	环氧玻璃钢 , n/mm2 (psi)	10 ( 1,450 )

#### 四、包装

包装方式20ml/支 30ml/支 250ml/支

#### 五、使用方法及注意事项

处理信息：

1) 运输过程中所有的运输箱内须放置冷冰袋以维持温度在8 以下。

2) 冷藏贮存的sct-3108 须回温之后方可使用，30ml 针筒须1 ~ 2 小时 ( 实际要求的时间会

随包装的尺寸/容积而变)。不要松开包装容器的嘴、盖、帽。注射器管的包装必须使嘴朝下放置。不可以加热解冻，因为可能会使胶水部分固化。

3) 为避免污染未用胶液，不能将任何胶液倒回原包装内。

## 使用指南：

把产品装到加胶设备上。很多类型的加胶设备都适合，包括：手动加胶机/时间压力阀、螺旋阀、线性活塞泵和喷射阀。设备的选择应该根据使用的要求。

- 1) 在设备的设定其间，确保没有空气传入产品中。
- 2) 为了得到最好的效果，基板应该预热（一般40 约20 秒）以加快毛细流动和促进流平。
- 3) 以适合速度（2.5 ~ 12.7mm/s）施胶。确保针嘴和基板及芯片的边缘的距离为0.025 ~ 0.076 mm，这可确保底部填充胶的最佳流动。
- 4) 施胶的方式一般为“i”型沿一条边或“l”型沿两条边在角交叉。施胶的起始点应该尽可能远离芯片的中心，以确保在芯片的填充没有空洞。施胶时“i”型或“l”型的每条胶的长度不要超过芯片的80%。
- 5) 在一些情况下，也许需要在产品上第二或第三次施胶。